



Rat der
Europäischen Union

Brüssel, den 21. November 2018
(OR. en)

14559/18
ADD 1

ENV 797
MI 870
DELECT 153

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Herr Jordi AYET PUIGARNAU, Direktor, im Auftrag des Generalsekretärs der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	19. November 2018
Empfänger:	Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Nr. Komm.dok.:	C(2018) 7499 final - Annex
Betr.:	ANHANG der Delegierten Richtlinie der Kommission zur Änderung — zwecks Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Blei in Loten zum Herstellen einer stabilen elektrischen Verbindung zwischen dem Halbleiterchip und dem Schaltungsträger in integrierten Flip-Chip-Baugruppen

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument C(2018) 7499 final - Annex.

Anl.: C(2018) 7499 final - Annex



Brüssel, den 16.11.2018
C(2018) 7499 final

ANNEX

ANHANG

der

Delegierten Richtlinie der Kommission

zur Änderung — zwecks Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Blei in Loten zum Herstellen einer stabilen elektrischen Verbindung zwischen dem Halbleiterchip und dem Schaltungsträger in integrierten Flip-Chip-Baugruppen

ANHANG

Anhang III Eintrag 15 erhält folgende Fassung:

„15.	Blei in Loten zum Herstellen einer stabilen elektrischen Verbindung zwischen dem Halbleiterchip und dem Schaltungsträger in integrierten Flip-Chip-Baugruppen	Gilt für die Kategorien 8, 9 und 11 und läuft ab am <ul style="list-style-type: none">– 21. Juli 2021 für die Kategorien 8 und 9, ausgenommen medizinische In-vitro-Diagnostika und Überwachungs- und Kontrollinstrumente in der Industrie;– 21. Juli 2023 für die Kategorie 8 Medizinische In-vitro-Diagnostika;– 21. Juli 2024 für die Kategorie 9 Überwachungs- und Kontrollinstrumente in der Industrie und für Kategorie 11.
15a.	Blei in Loten zum Herstellen einer stabilen elektrischen Verbindung zwischen dem Halbleiterchip und dem Schaltungsträger in integrierten Flip-Chip-Baugruppen, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: <ul style="list-style-type: none">– ein Halbleiter-Technologieknoten von 90 nm oder mehr;– ein einzelner Chip mit einer Größe von 300 mm² oder mehr in jeglichem Halbleiter-Technologieknoten;– gestapelte Chipbaugruppen mit einer Chipgröße von 300 mm² oder mehr oder Silizium-Interposer mit einer Größe von 300 mm² oder mehr.	Gilt für die Kategorien 1 bis 7 und 10 und läuft ab am 21. Juli 2021.“